

電磁波レーダ法による豆板探査に関する実験的検討

正会員 ○瀧 諭* 同 太田 達見**

非破壊法	電磁波レーダ法	豆板
鉄筋コンクリート	比誘電率	

1. はじめに

電磁波レーダ法による鉄筋のかぶり厚さの探査に関する報告は多いが、豆板等に関するものは少ない。また、同法による探査は、コンクリート打込み後、長い期間を経た構造物を対象とした例が多く、打込み直後からの経時変化を検討した報告はない。以上から、コンクリートの材齢や豆板の寸法・位置をパラメータとして、電磁波レーダ法による壁試験体の豆板探査実験を行い、探査特性を検討した。本報ではその結果を報告する。

2. 実験概要

2.1 探査の原理と手順

電磁波レーダ法による計測は、電磁波の反射を利用する。そして、その計測結果を処理した画像を基に、空洞や埋設物の有無、位置、深さなどを判定する。

同法では、送信アンテナから放射された電磁波が探査対象で反射し、受信アンテナに戻るまでの伝搬時間 t と電磁波の強度を計測する(図1参照)。この場合 ϵ_r がわかれば、 $t = (2t_1 + 2t_2)$ を基に、探査対象物の深度 h を次式で算出することができる(C: 真空中の電磁波速度)。

$$\frac{1}{\epsilon_r} \left(\frac{Ct}{2} \right)^2 = (h_0 + h)^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2 \quad \dots (1)$$

2.2 試験体仕様

本実験で用いた壁試験体を図2に示す。壁立上がり部は、幅1,840mm、高さ500mm、厚さ180mmである。計測では、図2に示すようにA面とB面を定めた。

壁試験体には、6本の鉄筋($S_1 \sim S_6$)と6個の豆板($M_1 \sim M_6$)を設置した。鉄筋径は $S_1 \sim S_4$ がD10, S_5, S_6 がD13である。 $M_1 \sim M_6$ の寸法と深度 h_m を表1に示す。豆板は、空隙率20%のポーラスコンクリート(W/C 26.1%)とし、普通コンクリート(W/C 56.6%)による健全部より11日早く製作した。以下では、健全部の材齢で考察する。

2.3 計測の装置と方法

計測は、専門の技術者がアンテナ周波数2.3GHzの市販装置を用いて、材齢1週、2週、4週の計3回実施した。材齢1、2週ではA面のみ、4週ではA、B両面を計測した。計測結果は、機器専用のソフトウェアを利用し画像処理した。以下では、図2(b)に示した上段と下段の断面について結果を考察する。

表1 豆板寸法と埋設深さ

豆板	幅	奥行	h_m^*
M1	50	100	0
M2	100	100	40
M3	150	100	0
M4	100	30	0
M5	100	50	0
M6	100	50	130

*A面からの距離

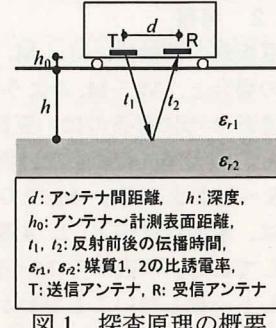


図1 探査原理の概要

3. 試験体の断面画像および考察

3.1 試験体の断面画像

A面側からの断面について、材齢1週の輝度(Bモード)画像を図3に示す。図中、(a)が下段、(b)が上段に対応する。図の縦軸と横軸はそれぞれ、伝搬時間 t 、壁表面の水平位置 x_i に対応し、受信した電磁波強度が濃淡で表示されている。 $t=4.2\text{ns}$ に観察される帯状の白線は、探査面の反対面(この場合B面)に対応する。

図3(a)では、頂部で $t=2.0$ である山型画像が $x_i=330, 690, 1,100, 1,460\text{mm}$ 近りに観察される。これらは $S_1 \sim S_4$ に対応する。また、頂部で $t=1.3$ である山型が $x_i=1,280\text{mm}$ 近りに観察される。これは S_5 に対応する。

図3(b)では、 $S_1 \sim S_5$ 以外の山型画像も観察されている。これらは $M_1 \sim M_5$ に対応する。山型画像の頂部は、健全部と豆板部の境界に対応する。 $M_1 \sim M_5$ のうち、 M_1, M_5 は1つの山型で表わされているのに対し、 $M_2 \sim M_4$ は x_i に沿って連なった2つの山型として表わされている。

材齢4週のA面上段の画像を図4に示す。図4と図3(b)を比較すると両者はほぼ同じであり、材齢1週から4

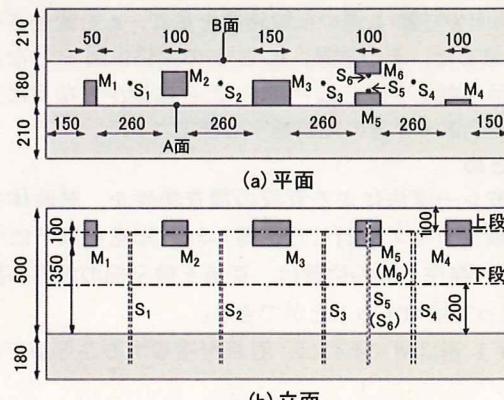


図2 壁試験体

週にかけて、画像で判読できる変化はなかったと言える。

材齢 4 週の B 面上段の画像を図 5 に示す。図 5 と A 面側の画像（図 4）を比べると、壁厚のほぼ中央に配した $S_1 \sim S_4$ は伝搬時間が A 面側とほぼ同じであることがわかる。これに対し、A 面からは境界が深い箇所にあった M_1, M_3 では、伝搬時間が短くなっている。また、B 面からの h が約 150mm である M_5 は、その検知が困難となっている。

3.2 考察

豆板部の画像は、 $M_1, M_5 (M_6)$ のように山型が 1 つの場合と、 $M_2 \sim M_4$ のように 2 つの場合があった。山型画像が 2 つになるのは、豆板の設計幅が 100mm 以上と広く、かつ近傍に鉄筋がない場合であった。

$S_1 \sim S_4$ および $M_1 \sim M_5$ での伝搬時間を表 3 に示す。同表には、A 面は材齢 1, 2, 4 週の、B 面は材齢 4 週の結果を示してある。同表から $M_2 \sim M_4$ での伝搬時間は、左右で必ずしも一致しないことがわかる。特に M_2 の A 面では顕著な差が生じている。その理由として、壁試験体への打込み時に、豆板を模したポーラスコンクリート片の内部に健全部のコンクリートの一部およびその自由水が侵入し、境界面が平滑になっていないことも考えられる。

また同表から、 $S_1 \sim S_4$ では、材齢の経過にともない伝搬時間が短くなったことがわかる。その理由として、材齢とともに含水率が低下したと考えられる。一方、豆板部では、こうした現象は必ずしも全箇所では生じていない。逆に M_2 では、材齢 1 週から 2 週にかけて伝搬時間が著しく増大している。その理由として、豆板部の材齢が健全部より 11 日長く含水率が安定傾向にあったことや、豆板を模したポーラスコンクリート内の水分が影響した可能性が考えられる。

表 3 の伝搬時間を基に、式(1)において ϵ_{r1} （この場合健全部の比誘電率）を設定すると、深度 h を算出できる。 $S_1 \sim S_4$ の ϵ_{r1} の推定のために、以下の評価関数 e を定義する。

$$e = \sum_{i=1}^4 (170 - h_{Si}^A - h_{Si}^B)^2 \quad \cdots (2)$$

ここに、 h_{Si}^A, h_{Si}^B は S_i の A 面、B 面からの推定深度であり、170(mm)は壁厚から S_i の鉄筋径を差し引いた値である。A, B 両面の材齢 4 週の伝搬時間を基に、 ϵ_r を変化させ深度 h を求めた。その結果、 ϵ_{r1} と e の関係は図 6 となる。同図に示したように、 $\epsilon_{r1}=10.0$ で e は最小となった。同値は、健全部の 4 週の比誘電率と推定される。

4.まとめ

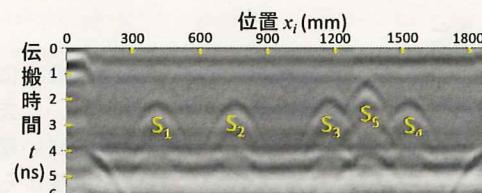
電磁波レーダ法による豆板の探査特性を、試験体を用いた実験によって検討した。得られた知見を以下に示す。

- 1) 豆板の存在とその位置は、豆板と健全部の境界の探査によって検知することができる。
- 2) 材齢 1 週以降であれば、豆板を検知することができる。

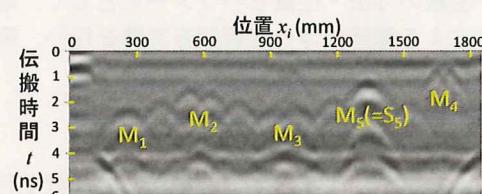
3) 材齢の経過にともない、健全部では伝搬時間は短くなつたが、豆板では各部で異なる傾向を示した。

4) 豆板部の画像は、豆板の幅が広くかつ鉄筋が存在しない場合に、山型が 2 つ連なって表れる。

謝辞 本検討の実施にあたり、(株)計測技術サービスの後藤健二氏に協力を得た。ここに記して、謝意を表する。



(a) 下段（豆板なし）



(b) 上段（豆板あり）
図 3 材齢 1 週・A 面の画像

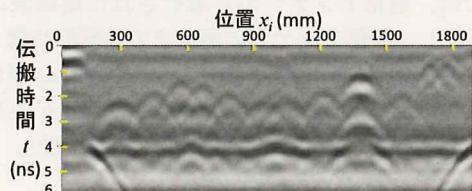


図 4 材齢 4 週・A 面の上段の画像

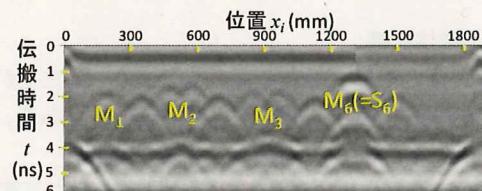


図 5 材齢 4 週・B 面の上段の画像

表 3 伝搬時間 t (単位:ns)

面	A		B	
	材齢	1週	2週	4週
S_1	2.00	1.97	1.95	2.04
S_2	2.01	1.97	1.96	2.04
S_3	1.92	1.89	1.89	2.11
S_4	2.07	2.00	1.99	2.00
S_5, M_5, S_6, M_6	1.26	1.27	1.25	1.22
M_1	2.34	2.27	2.31	1.90
M_2	左 右	1.50 1.66	1.64 1.97	1.63 1.57
M_3	左 右	2.32 2.21	2.21 2.15	2.30 2.17
M_4	左 右	0.75 0.75	0.81 0.78	0.78 0.80
		—	—	—

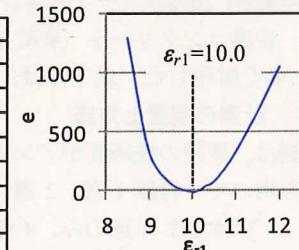


図 6 健全部での比誘電率
と評価関数の関係

* 清水建設 技術戦略室

** 清水建設 技術研究所

* Shimizu Corporation, Technology Planning Office

** Shimizu Corporation, Institute of Technology